

薄型化する部品内蔵基板の絶縁材料

林 栄一*, 大越 雅典*

Dielectric Materials for the Device Embedded Substrate

Eiichi HAYASHI* and Masanori OHKOSHI*

* 味の素ファインテクノ株式会社 (〒 210-0801 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-2)

* AJINOMOTO FINE-TECHNO CO., INC., (1-2 Suzuki-cho, Kawasaki-Ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0801)